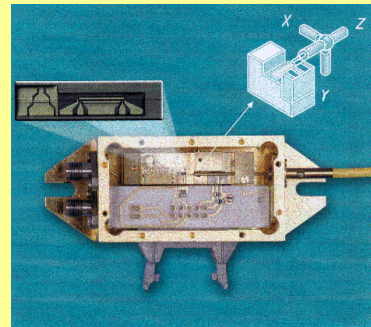


## ITG-Workshop

### Photonische Aufbau- und Verbindungstechnik



**15./16. Mai 2003**

best practice - Hochschule  
2003

**Hochschule Harz, Wernigerode**  
**Friedrichstr. 57, 38855 Wernigerode, Germany**

**VDE**

**Tagungsprogramm Workshop  
„Photonische Aufbau- und Verbindungstechnik“  
Wernigerode**

**Donnerstag, 15. Mai 2003**

13:00 Uhr                    Begrüßung                    Rektorin Fr. Prof. Assenmacher /  
Prof. Fischer-Hirchert

**Session 1: "Packaging"**

**Chairman: U. Fischer-Hirchert**

- 13:15                    Die 5. Leiterplattengeneration – EOCB (invited)  
*W. Scheel, Fraunhofer IZM Berlin*
- 13:45                    Elektro-Optische Leiterplatten mit konventioneller Technik fertigen?!  
*K. Schmieder, KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf*
- 14:10                    Neues Low-Cost Modul Package für bidirektional Datenübertragung  
*V. Plickert, L. Melchior, Infineon Technologies, Berlin*
- 14:35                    Low Cost Packages für 1300nm VCSEL - vom TO zum SMD.  
*M. Weigert, Infineon Technologies AG, Berlin*
- 15:00                    The Road to Recovery of the Optoelectronic Component Industry  
*M. A. Tolbert, S. Ragona,  
EXFO Burleigh Products Group, Victor (USA)*
- 15:25                    Kaffeepause (Foyer)**

## Session 2: " Mikrooptische Komponenten und Systeme"

Chairman: **U. Wallrabe**

- 16:00 „Mikrooptische Elemente für die hochbitratige Datenübertragung“ (invited)  
*K. Schulz, Merge Optics , Berlin*
- 16:30 Optisches Element für 1x2 Einmoden-Faserschalter aus anisotrop geätzttem Silicium  
*D. Nüsse, M. Hoffmann, E. Voges*  
*Universität Dortmund, Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik, Dortmund*
- 16:55 Automatisierte Justage und Montage von mikrooptischen Singlemode-Faserschaltern  
*F. Wippermann, K. Kubitz, T. Harzendorf, R. Göring*  
*pyramid optics GmbH , Lederhose*
- 17:20 Aufbau und Verbindungstechnik für mikrooptische Abstandssensoren (Modulares Fertigungskonzept)  
*U. Hollenbach, U. Wallrabe, J. Mohr, T. Oka*  
*FZ Karlsruhe GmbH, Institut für Mikrostrukturtechnik, Karlsruhe*
- 17:45 Aufbautechniken für zweidimensionale faseroptische Mikrokomponenten  
*A. Menshig*  
*MiLaSys technologies GmbH, Stuttgart*

**18:15 - 19:30 “come together“ im Foyer mit kleinem Imbiss und Hasseröder Bier**

**Freitag, 16. Mai 2003**

**Session 3: "Optische Verbindungstechniken"**

**Chairman: G. Walf**

- 9:00      Technologien für optische Steckerschnittstellen (BMBF-Projekt OPST II)  
*A. Ambrosy<sup>1</sup>, M. Beck<sup>2</sup>, I. Frese<sup>3</sup>, K. Rueß<sup>1</sup>, S. Schmid<sup>4</sup>t, J. Ziegler<sup>4</sup>*  
*<sup>1</sup>Alcatel SEL AG, <sup>2</sup>OSI GmbH, <sup>3</sup>IMM Mainz, <sup>4</sup>Rosenberger GmbH*
- 9:30      Multifaserkopplung für schräg zur Kristallkante liegende Wellenleiter  
*Th. Rosin, H. Ehlers, M. Schlak*  
*Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik Heinrich-Hertz-Institut (HHI)*  
*Berlin*
- 9:55      Waveguide-fed photo diodes with optical spot size expanders integrated  
in modules with optimized fiber-chip coupling  
*U. H. P. Fischer-Hirchert<sup>3</sup>, J. Honecker<sup>1</sup>, A. Umbach<sup>1</sup>, D. Trommer<sup>1</sup>, Th.*  
*Eckhardt<sup>2</sup>, <sup>1</sup>U2T Photonics AG, <sup>2</sup>HHI Berlin, <sup>3</sup>HS-Harz Wernigerode*
- 10:20      Sondertechnologien der Faseroptik - Faserlinsen und Laserschweißen  
*H. Schröder, G. Lang, N. Arndt-Staufenbiel, J. Krissler, W. Scheel*  
*Fraunhofer IZM Berlin*
- 10:45      Zukunft der Steckverbinder, Steckverbinder der Zukunft  
*W. Coenning, Diamond GmbH, L.-Echterdingen*
- 11:10      Kaffeepause (Foyer)**

## Session 4: "Lötprozesse"

**Chairman: A. Ambrosy**

- 11:45      Laserlöten mikrooptischer Komponenten  
*R. Eberhardt, H. Banse, W. Stöckl,  
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF), Jena*
- 12:10      Betrachtung von galvanisch erzeugten AuSn Bumps unter  
geometrischen Gesichtspunkten und die Auswirkungen auf den  
Bumpingprozess und Flip-Chip-Montage  
*M. Hutter, Fraunhofer IZM, Berlin,*
- 12:35      A Fluxfree Soldering Process for Local Hermetic Sealing of  
Optoelectronic Subassemblies  
*G. Elger, L. Shiv, C. Ching-Hua, A. Kilian, A. Hase, M. Heschel,  
J. Kuhmann, Hymite GmbH, Berlin, Lyngby (DK)*
- 13:00      **Abschlussworte und Ende des Workshops**